

## 半自动切割贴膜机

### ■ 概要

设备采用丝杆导轨机构、触摸屏及PLC模块化软件控制，实现了自动拉膜、贴膜、切膜等工艺过程，适用于对晶圆进行切割前的背面贴膜。

### ■ 优势

- 采用Kinco触摸屏，进行对设备的参数设置。
- 配备软制防静电滚轮，贴膜压力可线性调节。
- 采用特氟龙处理的真空吸附工作盘，高度可根据晶圆厚度不同进行自适应，可有效的保护晶圆。



### ■ 规格

晶圆尺寸	Ø150mm, Ø200mm
晶圆厚度	150 μm-500 μm
标准膜宽度	6吋为 230mm、8吋为 300mm
贴膜方式	半自动滚轮式
批生产能力	8吋 50 片 / H; 6吋 60 片 / H (熟练使用情况下)
设备电源	AC - 220v ± 15% 50Hz 5A 1.2KW
压缩空气	0.5-0.6 MPa、100L / Min、Ø8气管
环境温度	20℃ - 30℃
设备尺寸	620mm (宽) × 1080mm (深) × 550mm (高)
设备重量	160KG